

广东富信科技股份有限公司

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《广东富信科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《广东富信科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、公司的主营业务

公司是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一，主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。

半导体热电技术解决方案能够广泛应用于通信、消费电子、工业、汽车等众多领域。其中，在通信领域，公司已成为国内少数具备大规模稳定量产 Micro TEC 能力的企业之一，主要客户包括 Coherent、华工科技、索尔思光电等国内外知名企业，并承担国家重点研发计划项目；在消费电子领域，公司已经深耕二十余年，依靠研发优势、技术优势和全产业链的业务布局，以热电整机应用为技术解决方案载体，成功将半导体热电制冷技术与啤酒机、恒温床垫、冻奶机等众多创新性使用场景相结合，实现了半导体热电技术在消费领域的大规模产业化应用。

二、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 27,000.00 万元（含），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目	20,201.11	15,000.00
2	技术改造与信息化升级项目	5,381.10	4,000.00

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		33,582.21	27,000.00

注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入及拟投入的财务性投资金额。

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为广东富信热电器件科技有限公司，建设地点位于广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑三路20号公司现有厂区，建设周期为3年。项目总投资金额20,201.11万元，主要投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等。本次项目公司拟对现有场地进行装修改造，并引进先进自动化晶圆加工、精密封装及检测设备，项目建成达产后将新增微型热电制冷器件（Micro TEC）产能4,200万片/年，以满足下游客户持续增长的订单需求。

2、项目实施的必要性

（1）光模块市场需求快速增长，公司现有产能亟待通过本项目进一步提升

近年来，人工智能、数据中心、云计算行业高速发展使光通信产业景气度持续提升，算力基础设施加速导致的光模块使用需求持续放量，多数光模块企业现有产能难以匹配中长期交付需求，开始加大资本投入，并提前锁定上游供应链产能，抢占市场份额。公司主要客户中，Coherent 2025年7月至2026年6月资本性支出达到11.03亿美元，同比增长150.19%。

随着公司下游光模块企业加快产能建设，客户对公司 Micro TEC 产品亦不断提出增量采购需求，公司现有产能亟待进一步提升。若公司不能及时扩大提升产品制造和批量交付能力，将难以充分满足现有客户增量订单、新客户导入及新产品后续产业化需求，并对公司把握本轮光通信产业发展机遇、巩固市场地位和提高盈利能力造成一定不利影响。

（2）通过本项目的实施提高公司生产工艺技术水平，强化市场竞争力

通信领域光模块企业客户对上游器件供应商的技术研发、质量控制、可靠性验证及持续供货能力具有较高要求。产品完成客户验证后，供应商仍需具备与客户需求相匹配的规模化生产和稳定交付能力，才能将研发项目和客户认证成果持续转化为批量订单。市场竞争已不仅体现为产品技术指标能满足，更体现为批量制造能力、产品一致性与质量稳定性的控制能力。

同时，随着全球人工智能产业发展推动算力需求高速增长，下一代算力基础设施对数据传输的高速率、高带宽、低功耗提出更高要求，光模块技术快速迭代发展，产品向 800G、1.6T 等更高速率，以及光电共封装（CPO）等技术方向演进。为此，公司亟须与下游客户保持同步发展与技术进步，在技术解决方案和工艺水平上持续满足下游客户的创新性、定制化需求。

公司本次募集资金投资项目通过引进先进自动化晶圆加工、精密封装及检测设备，提升关键工序的过程控制能力，有助于进一步提升公司产品良率水平，提高对客户新型光模块产品订单的响应速度，以及大批量集中交付的稳定性，提升公司科技创新成果转化效率，从而深度绑定下游客户的长期供货需求，强化公司市场竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）国家产业政策为本项目的实施提供了良好的政策基础

近年来，国家围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设，加强算力设施支撑等战略方向，持续出台一系列产业扶持与鼓励政策。《十五五规划纲要》提出，深入推进东数西算工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网，加快国家枢纽算力设施集群建设，加强高性能高质量智算资源供给，加快突破关键零部件、元器件。《国务院关于产业链供应链安全的规定》要求提升产业链供应链安全可控水平，促进产业链供应链高质量发展。工信部《“人工

智能+信息通信”创新发展实施意见（2026-2028 年）》提出，加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，加速技术方案成熟。

微型热电制冷器件作为高速光模块的上游关键核心电子器件，对保障我国光通信产业供应链自主可控具有重要意义，符合上述国家产业政策支持发展方向，因此本项目实施具有良好的政策环境。

（2）公司具备实施该项目的深厚技术积累和丰富生产经验

公司深耕半导体热电技术二十余年，在碲化铋基材料制备、晶圆加工、精密封装、可靠性验证等方面形成了深厚技术积累。2026 年 1-6 月，公司半导体热电器件实现销售收入 12,270.89 万元，其中通信领域微型热电制冷器件(Micro TEC)实现销售收入 5,616.46 万元，具备丰富的大规模量产经验。

目前，公司应用于 400G、800G 高速率光模块的 Micro TEC 已实现批量供货，1.6T 高速率光模块的 Micro TEC 已实现小批供货，应用于光电共封装(CPO)技术的产品已在送样验证阶段。公司本次募集资金投资项目建设系在公司既有业务和技术路线上进行扩大生产和升级，技术路径清晰。公司已实现从热电材料到热电器件的全产业链覆盖，形成了较为成熟的内部研发协调机制，能够根据客户需求开展定制化方案设计开发，并对研发、生产及质量控制等关键环节进行有效把控。因此，公司坚实的技术研发基础、完整的产业链布局和较为成熟的产业化经验，能够为本次募投项目的顺利实施提供有力的技术保障。

（3）公司优质的客户资源为项目新增产能的消化提供了充分保障

光模块供应链认证周期长、准入壁垒高，客户对供应商的产品设计能力、质量稳定性、批量交付能力和过程管控具有较高要求，更换供应商通常拥有高昂的替换成本并需要重新进行可靠性验证，因此客户在完成供应商导入后一般能够维持长期合作关系。

经过多年验证与市场开拓，公司 Micro TEC 已形成包括 Coherent、华工科技、索尔思光电等国内外知名企业在内的优质稳定客户资源，能够通过定制化开发、技术服务及持续的产品升级，深入挖掘现有客户需求，公司现有客户基础、市场开拓能力及产品产业化经验，能够为本次募投项目新增产能消化及预期效益实现提供良好的市场保障。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 20,201.11 万元，计划使用募集资金投资 15,000.00 万元。
项目总投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资额的比例	其中：拟使用 募集资金金额
1	建筑工程投资	344.41	1.70%	15,000.00
2	设备购置及安装	15,085.22	74.68%	
3	基本预备费	771.48	3.82%	-
4	铺底流动资金	4,000.00	19.80%	-
合计		20,201.11	100.00%	15,000.00

5、经济效益测算

本项目有助于公司扩大 Micro TEC 产品产能，提升规模化制造和批量交付能力。项目建成并达产后，预计将进一步增强公司盈利能力，对公司持续发展具有积极促进作用。

6、项目报批事项

截至本说明公告日，本项目的投资备案等相关报批手续尚在准备过程中。
公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

（二）技术改造与信息化升级项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为本公司，建设地点位于广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑三路 20 号及容桂街道华口社区恒华路 1 号公司现有厂区，建设周期为 3 年。项目总投资金额 5,381.10 万元，主要投资内容包括自动化及研发检测设备、数据中心以及智慧园区、MES 系统升级等。

2、项目实施的必要性

（1）顺应智能制造发展趋势，提升生产效率与产品质量

近年来，通过自动化装备及信息化系统实现智能制造，已成为现代制造业保障产品质量稳定性、提升生产效率的关键基础。公司自 2003 年成立以来，已专注半导体热电技术相关产品制造 20 余年，部分半导体热电器件、热电系统生产

线由于建成时间相对较早，焊接、检测环节自动化程度相对较低，还依赖人工操作，部分设备出现磨损、老化现象，部分区熔、研磨工艺需要升级，导致产品质量的稳定性和生产效率存在提升空间。

因此，公司拟通过本次项目建设，进一步增加先进自动化设备及检测设备，对热电器件及系统产线进行技术改造升级，实施设备更新换代和工艺升级，从而进一步提高公司智能制造水平。一方面，相比于人工操作，高端自动化设备的生产效率和工艺精度更高，尤其随着我国劳动力成本的逐步上升，自动化设备的成本优势愈发明显；另一方面，能够满足下游客户对产品质量稳定性、性能可靠性及订单交付速度的更高要求，从而为巩固公司行业地位，持续拓展市场份额提供坚实的支撑。

（2）推进信息系统升级建设，强化公司技术创新能力

近年来，信息化系统从单纯的业务辅助工具逐渐演变为支撑企业精益生产、全流程质量管控与高质量发展的重要基础设施，加快信息化升级建设成为制造型企业顺应产业变革趋势的必然选择。公司拟通过本项目新建数据中心，并对 MES、WMS 系统模块进行升级改造，从而进一步打通从原材料采购、生产制造、质量检测到产品交付的全链条数据，实现生产过程及运营管理的数字化升级，从而进一步提升公司管理运营效率、实现降本增效，促进公司的可持续健康发展。

同时，随着半导体热电技术应用场景不断拓展以及新产品的升级迭代，对研发设备的精度等级、测试效率和覆盖范围提出了更高要求。本项目通过增加研发设备及高精度检测仪器，将进一步提升公司在热电材料性能、器件可靠性验证等方面的研发测试能力，加快新产品、新技术研发进程，缩短研发周期，从而强化公司的技术创新能力，提升公司综合竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）国家相关政策支持企业实施技术改造与信息化升级

2024 年 3 月，工业和信息化部等七部门联合发布了《推动工业领域设备更新实施方案》，提出依法依规引导企业淘汰落后设备、使用先进设备，提高生产效率和技术水平，鼓励围绕生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级，优化组织结构和业务流程。2025 年 7 月，工业和信息化部等八部门制定了《机械

工业数字化转型实施方案》，提出加快推进企业数智化转型，推进老旧设备更新和“哑”设备改造，支持企业实施软硬一体化改造，推动生产设备和信息系统全面互联互通，促进数字化集成应用创新，提升企业数字化精益管理水平。

公司通过本次募投项目实施技术改造，增加新型自动化先进设备替代使用年限较长的老旧生产设备，进行信息化系统改造升级和设备更新换代，受到国家相关政策支持。

(2) 本项目的实施具有良好的市场条件

本项目主要通过引入智能仓储，增加视觉自动挑选设备、自动印锡机、自动固晶机、自动焊线设备等，对公司现有物料仓储及部分半导体热电器件、热电系统生产线进行自动化技术改造。近年来公司充分发挥技术研发优势与全产业链协同效应，凭借专业的服务能力，为客户提供精准的温度、湿度控制解决方案。除了在通信领域实现高速增长外，得益于公司在消费电子、工业等各应用领域的持续拓展，2026 年 1-6 月，公司除 Micro TEC 外，其他半导体热电器件实现销售收入 6,654.43 万元，同比增长 8.37%，热电系统销售收入 6,386.62 万元，同比增长 11.67%，相关产品亦获得市场广泛认可。

通过本次技术改造，公司可更好地控制产品质量，提升生产效率，加快新产品的升级迭代，满足客户需求。因此，良好的市场条件为本项目的顺利实施奠定了基础。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 5,381.10 万元，计划使用募集资金投资 4,000.00 万元。项目总投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资额的比例	其中：拟使用募集资金金额
1	建筑工程投资	640.00	11.89%	4,000.00
2	设备购置及安装	4,484.86	83.34%	
3	基本预备费	256.24	4.76%	-
合计		5,381.10	100.00%	4,000.00

5、经济效益测算

本项目为技术改造与信息化升级项目，不涉及新增产能，因此不单独进行经济效益测算，项目实施后能够有效提升公司现有产线的自动化、信息化水平。

6、项目报批事项

截至本说明公告日，本项目的投资备案等相关报批手续尚在准备过程中。公司将按照相关法律法规要求及时、合规办理。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中 8,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

本次使用部分募集资金用于补充流动资金，可以满足公司后续业务扩张需要，保障公司可持续发展，降低经营风险。此外，本次发行完成后，能够进一步优化公司资本结构，减少对债务融资的需求，降低资产负债率和财务风险。因此，本次募集资金部分用于补充流动资金具备必要性。

3、项目实施的可行性

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所的相关监管规定，具有可行性。公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。因此，本次募集资金用于补充流动资金具备可行性。

四、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务

公司是国内外少数全产业链半导体热电技术解决方案及应用产品提供商之一，主营业务为半导体热电器件及以其为核心的热电系统、热电整机应用产品的研发、设计、制造与销售业务。

其中，半导体热电器件是公司面向通信领域的重要业务方向，下游广泛应用于高速光通信、数据中心互联、AI 算力基础设施等新一代数通和电信相关应用

场景。公司主营产品中的微型热电制冷器件，主要用于对高速光模块中激光器等温度敏感元器件进行主动精准控温，属于光通信产业链中的关键基础器件，与国家重点支持的算力基础设施建设、提升产业链供应链安全可控水平方向高度契合。

公司本次募集资金投资项目包括微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目、技术改造与信息化升级项目和补充流动资金项目。上述项目均围绕公司当前主营业务和核心技术方向展开，有助于提升公司在高速光通信产业链中的参与深度和配套能力，增强 Micro TEC 产品的产能供给和市场竞争能力，提高公司整体生产经营效率和智能制造能力，属于科技创新领域的主营业务投资。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，重点投向应用于通信领域的 Micro TEC 产能扩建和技术改造与信息化升级，符合公司科创板定位和主营业务发展方向。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升

公司本次募投项目中，微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目相关产品对材料制备、晶圆加工、精密封装、可靠性验证、自动化检测及质量控制等环节要求较高。本项目将通过新增先进划片、贴片、焊接、测试及可靠性验证设备，提升公司关键工序的自动化、智能化、精密化水平，增强生产过程的数据化、标准化和可追溯能力，从而进一步完善工艺、制造、测试平台，提升关键技术产业化转化效率，推动公司由技术研发优势进一步向规模化制造优势转化，为产品持续迭代和技术升级奠定基础。同时，本项目将进一步完善公司 Micro TEC 产品布局。随着 400G、800G、1.6T 及更高速率光模块需求持续增长，CPO 等新型技术路线加速演进，公司通过本次项目建设，能够更好地匹配下游客户新型产品对高性能、高可靠性微型热电器件产品的需求。

技术改造与信息化升级项目，旨在围绕公司现有物料仓储及生产线进行自动化技术改造，同时进一步增加行业先进研发、生产、检测装备，对公司整体生产经营进行信息化升级，从而提高公司智能制造水平及生产经营效率，属于科技创新领域。

综上，本次募集资金投资项目将有效促进公司技术创新、产品创新、制造能力提升及科技成果产业化转化，进一步增强公司在通信领域的核心竞争力和持续创新能力。本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策导向、科创

板定位及公司长期战略发展规划。

五、结论

综上所述，公司认为：本次募集资金用途符合产业发展方向、紧密围绕公司主营业务展开、属于科技创新领域、服务国家发展战略，是公司紧抓行业发展契机、发挥自身竞争优势的重要举措，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日